

证券代码：688209

证券简称：英集芯

公告编号：2023-001

深圳英集芯科技股份有限公司 关于对外投资设立境外全资子公司和孙公司的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟投资标的名称：全资子公司名称：新加坡英集芯科技有限公司(以下简称“新加坡英集芯”，暂定名，最终以当地登记机关核准登记名称为准)；孙公司名称：美国英集芯半导体有限公司。（以下简称“美国英集芯”，暂定名，最终以当地登记机关核准登记名称为准）
- 拟对外投资金额：深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟对外投资总金额为 300 万美元，其中新加坡英集芯注册资本 7.5 万美元，拟投资总额 100 万美元；美国英集芯注册资本 200 万美元，拟投资总额 200 万美元（设立美国英集芯的资金来源于新加坡英集芯自有资金以及公司对新加坡英集芯的借款）。
- 特别风险提示：1、本次对外投资尚需在境内办理外汇审批以及在新加坡、美国办理注册登记等相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。2、新加坡、美国与中国有不同的政治法律制度以及不同的文化背景，新加坡、美国当地业务拓展模式与中国也存在差异，本次对外投资存在一定的人才、技术和管理等方面的风险，后续实际运营过程中也可能面临国内外政治经济环境变化等风险。

一、对外投资概述

为进一步优化公司战略布局，拓宽公司业务发展道路，满足国际化业务发展需求，提升公司持续经营能力，增强公司核心竞争力及综合实力，公司拟在新加坡投资设立全资子公司新加坡英集芯，新加坡英集芯成立后，拟以其为投资主体

在美国设立孙公司美国英集芯，设立美国英集芯的资金来源于新加坡英集芯自有资金以及公司对新加坡英集芯的借款。新加坡英集芯与美国英集芯主要从事集成电路、计算机软硬件、电子产品、测试设备的技术开发及销售、技术服务、技术转让、技术咨询。

公司于 2023 年 2 月 6 日召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对外投资设立境外全资子公司和孙公司的议案》，同意公司拟在新加坡投资设立全资子公司，子公司成立后，以其为投资主体在美国投资设立孙公司。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。

本次对外投资尚需商务主管部门、发展和改革主管部门、外汇管理部门等相关政府部门审批或备案；且尚需取得新加坡、美国当地主管机关的审批或登记。

二、投资标的基本情况

（一）全资子公司

标的公司的中文名称：新加坡英集芯科技有限公司

标的公司的英文名称：Injoinic Tech PTE.LTD

注册资本：7.5 万美元

投资总额：100 万美元

股权结构：深圳英集芯科技股份有限公司持股 100%

标的注册地：新加坡

拟经营范围：集成电路、计算机软硬件、电子产品、测试设备的技术开发及销售、技术服务、技术转让、技术咨询

（二）孙公司

标的公司的中文名称：美国英集芯半导体有限公司

标的公司的英文名称：Injoinic Semiconductor Corporation

注册资本：200 万美元

投资总额：200 万美元

股权结构：新加坡英集芯持股 100%

标的注册地：美国

拟经营范围：集成电路、计算机软硬件、电子产品、测试设备的技术开发及销售、技术服务、技术转让、技术咨询

以上事项，具体以相关政府部门以及新加坡、美国当地主管机关登记或审批为准。

三、对上市公司的影响

本次对外投资设立新加坡英集芯、美国英集芯有利于公司全球化布局，协助公司在海外业务拓展，符合公司整体发展战略规划，不会对公司财务状况、主营业务及持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

1、本次对外投资尚需在境内办理外汇审批以及在新加坡、美国办理注册登记等相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。2、新加坡、美国与中国有不同的政治法律制度以及不同的文化背景，新加坡、美国当地业务拓展模式也与中国存在差异，本次对外投资存在一定的人才、技术和管理等方面的风险，后续实际运营过程中也可能面临国内外政治经济环境变化等风险。公司将进一步了解和熟悉新加坡、美国法律体系、投资体系等相关事项，积极开拓业务，切实降低与规避因新加坡英集芯、美国英集芯的设立与运营带来的相关风险。

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会

2023 年 2 月 7 日